

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-242029

(43)公開日 平成4年(1992)8月28日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

HO1H 33/66

B 6969-5G

審査請求 未請求 請求項の数6(全 8 頁)

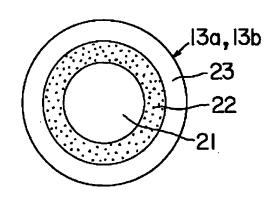
(21)出願番号	特顯平3-1733	(71)出顧人	000003078 株式会社東芝		
(22)出願日	平成3年(1991)1月10日	(72)発明者	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地		
		(12/26/21)	東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内		
		(72)発明者	大川 幹 夫		
			東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中 工場内		
		(72)発明者	與 経 世		
			東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中		
			工場内		
		(74)代理人	弁理士 佐藤 一雄 (外3名) 最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 真空パルプ

(57) 【要約】

〔目的〕 電流遮断時における高蒸気圧性材料から低蒸 気圧性材料へのアークの移行が停滞せずに容易に行わ れ、低サージ機能と大電流遮断機能という二つの相反す る機能を有した真空パルプを提供する。

〔構成〕 高導電性材料と耐弧性材料とから構成される 接点を具備してなる真空パルプにおいて、前記接点は、 それぞれ組成の異なる第1組成領域 [I]、第2組成領 域〔II〕、および該〔I〕と〔II〕の中間位置に介在す る中間領域(M)から構成される。〔I〕は低サージ性 のAg-WC系合金からなり、〔II〕は大電流遮断性の Cu-Cr系合金からなり、 [M] は [I] と (II) の 中間的な性質を有する合金からなる。〔M〕の導電性成 分の量が、前記各領域中の導電性成分量に対して〔II〕 **> [M] > [I] の範囲にある。**



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】高導電性材料と耐弧性材料とから構成され る接点を具備してなる真空パルプにおいて、前記接点 が、それぞれ組成の異なる第1組成領域 [I]、第2組 成領域 (II) 、および該第1組成領域 [I] と第2組成 領域(II)の中間位置に介在する中間領域(M)から構 成され、前記第1組成領域〔Ⅰ〕が低サージ性のAg-WC系合金からなり、前配第2組成領域〔II〕が大電流 遮断性のCu-Cr系合金からなり、前記中間領域 [M] が前記第1組成領域 [I] と前記第2組成領域 10 [II] の中間的な性質を有する合金からなり、前記 [M] の導電性成分の量が、前配各領域中の導電性成分 量に対して (II) > (M) > (I) の範囲にあることを 特徴とする接点、を具備してなる真空パルブ。

【請求項2】前記第1組成領域〔1〕は、高導電性材料 が10~50重量%のAg、残部の耐弧性材料がWCか らなり、前記第2組成領域 [II] は、高導電性材料が2 0~80重量%のCu、残部の耐弧性材料がCrからな ること、を特徴とする接点を具備した請求項1に記載の 真空パルブ。

【請求項3】前記中間領域 [M] は、高導電性材料がA gまたは/およびCuからなり、耐弧性材料がCrまた は/およびWCからなること、を特徴とする接点を具備 した請求項1または2のいずれかに記載の真空パルプ。

【請求項4】前記第1組成領域 [I] の高導電性材料が AgおよびCuからなり、該高導電性材料の含有量は1 0~50重量%の範囲にあり、Cuの量はAg量に対し て40%以内であること、を特徴とする接点を具備した 請求項1または3のいずれかに記載の真空パルプ。

【請求項5】前記中間領域〔M〕における耐弧性成分C 30 r+WCは、前記第1組成領域[I]に接する一方の端 部から前記第2組成領域〔II〕に接する他方の端部に向 かってCr/WCの比率が前記第1組成領域〔I〕の耐 弧性成分量から前記第2組成領域(II)の耐弧性成分量 へと段階的にまたは連続的に変化するように構成したこ と、を特徴とする接点を具備した請求項1~4のいずれ か1項に記載の真空パルプ。

【請求項6】前記第1組成領域〔I〕、前記第2組成領 域〔II〕および前記中間領域〔M〕の各領域が、前記接 点の中心から半径方向に [II] [M] [I] の順にまた 40 は〔I〕(M〕(II)の順に配置されたことを特徴とす る接点、を具備してなる請求項1~5のいずれか1項に 記載の真空パルプ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、真空開閉装置に係り特 に遮断容量が大きく、かつ低サージ性(裁断電流特性が 優れていること)を持つ真空パルプに関するものであ

[0002]

2

【従来の技術】真空開閉器は、他の開閉器に比較し、小 型、軽量、メンテナンスフリー、環境調和等種々の優れ た特徴を有するため、近年次第にその適用範囲が拡大さ れてきた。真空しゃ断器は、真空中でのアーク拡散性を 利用して高真空中で電流しゃ断を行なうものであり、そ の側断面を示した図2を参照し説明する。

【0003】真空しゃ断器は真空気密に保たれたしゃ断 室1を有し、これは絶縁材料によりほぼ円筒状に形成さ れた絶縁容器2と、この両端に封止金具3a、3bを介 して設けた金属製の蓋体4a,4bとで構成されてい る。しゃ断室1内には、導電棒5、6の対向する端部に 取付けられた一対の固定電極7、可動電極8が配設され る。可動電極8の導電棒6にはペローズ9が取付けら れ、しゃ断室1内の真空気密を保持しつつ可動電極8が 軸方向に移動する。ペローズ9の上部には金属製のアー クシールド10が設けられ、ベローズ9がアーク蒸気で 覆われることを防止している。同様に金属製のアークシ ールド11は、しゃ断室1内において固定電極7および 可動電極8を覆うように設けられ、絶縁容器2がアーク 蒸気で覆われることを防止している。通電中は固定接点 13 bに可動接点13 aが接触しており、電流のしゃ断 は導電棒を下方向へ移動させ、この両接点の接触を断つ ことにより行なう。

【0004】次に、導電棒5,6と電極7,8、電極 7, 8と接点13a, 13bとの相互の固定構造につい て、図2における可動電極8周辺の詳細を示した図3を 参照し説明する。可動電極8は導電棒6に符号12で示 されたろう付または図示しないかしめ等により固定さ れ、可動接点13aは可動電極8に符号14で示された ろう付または図示しないかしめ等により固定される。固 定側の固定電極7と接点13bとの固定方法も同様であ る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】真空開閉器用接点に要 求される要件として、(1)溶着性が少ないこと、 (2) 耐電圧が高いこと、(3) 耐消耗性に優れるこ と、(4)接触抵抗が低く安定していること、等があ る。この他に最近の真空開閉装置に対する期待が一層高 まり、(5)低サージ機能を有すること、(6)大電流 しゃ断機能を有することが要求されるが、この二つの要 求は相反するものである。

【0006】まず、低サージ機能を有するための要件に ついて説明する。電動機負荷等の誘導回路で電流をしゃ 断する時などにおいて、過度のサージ電圧を発生させ、 負荷機器の絶縁を破壊させる恐れがある。この異常サー ジ電圧の発生原因は、真空中におけるしゃ断時に低電流 側に発生する電流さい断現象(交流電流波形の自然ゼロ 点を待たずに強制的に電流しゃ断が行なわれること。) によるものである。 異常サージ電圧の値 V は回路のサ

50 ージインピーダンス Z と電流さい断値 I の積、すな

わちV 比例Z ・Ⅰ で表わされ、異常サージ電圧V を低くするためには、つまり低サージ機能を有するた めには、電流さい断値 I を小さくしなければならな い。従って、しゃ断時において、アークによって可動接 点13aと固定接点13bの各表面からイオン、金属粒 子が多く蒸発して両接点間に浮游し、アークが容易に接 続されなければならない。従って、接点13a,13b に用いられる材料は、大電流をしゃ断する時のみなら ず、開閉電流が小さくて接点の温度上昇が小さい場合で あっても蒸発性の高い高蒸気圧性を有することが要求さ 10 れる。

【0007】このような低サージ機能を満たすものとし て、高蒸気圧性材料であるAgを含有したAg-WC合 金が知られている。この合金から成る接点は、(1) WCの介在が接点表面からのイオンの放射を容易にさせ ること、(2) 電界放射電子の衝突による電極間の加 熱に基づく接点表面から金属粒子の蒸発を促進させるこ と、(3) 接点材料中の炭化物がアークにより分解 し、荷電体を生成すること、等により、優れた低サージ 機能を有している。この他にこの機能を有する材料とし 20 て、高蒸気圧性材料であるCuを含有したCu-Cr合 金、Cu-Bi合金等が知られている。

【0008】これに対し、もう一方の相反する要件であ る大電流しゃ断機能を有するためには接点が低蒸気圧性 の材料から成ることが要求される。大電流をしゃ断する 場合には接点の表面温度は極めて高温となるが、このよ うな場合であってもアークによる接点表面からの蒸発量 が少なく、両接点間にイオン、金属粒子がほとんど浮遊 しない状態でなければしゃ断性が損われることとなる。 従って一般にどちらか一方の機能向上を追及すると、も 30 う一方の機能が低下する。

【0009】この二つの相反する要件を満たすための手 段として、接点を高蒸気圧性材料と低蒸気圧性材料の二 種類の材料から構成するものがある。電流をしゃ断する ために通電中接触していた両接点が離れる際において、 初めに高蒸気圧性材料から成る部分から多くのイオン、 金属粒子が蒸発して接点間に浮游し、アークがこれに導 かれて両接点における高蒸気圧性材料同志に接続され る。低サージ機能が満たされるために必要な時間経過後 両接点における高蒸気圧性材料同志に接続されていたア 40 一クを両接点における低蒸気圧性材料同志に接続される ように、アークを移行させる。これは、図5に示された コイル電極44、図6に示されたスパイラル電極45等 を用いて、磁界Hを制御することにより両接点間に浮遊 するイオン、金属粒子の分布を変えて強制的にアークを 移行させるという方法等により行なうことができる。

【0010】しかし、低電流しゃ断時にも低サージ機能 を有する髙蒸気圧性材料の物性と、大電流しゃ断機能を 有する低蒸気圧性材料の物性とでは蒸気圧性という点に おいて大きく異なる。このため、磁界例えば縫磁界Hに 50 配第2組成領域 (II) の耐弧性成分量へと段階的にまた

より両接点間に存在するイオン、金属粒子の分布を変え ても、アークが高蒸気圧性材料から成る部分と低蒸気圧 性材料から成る部分との境界上に停滞し、容易に移行し ない。従って、接点を高蒸気圧性材料と低蒸気圧性材料 とを単純に組み合せて構成しただけでは低サージ機能と 大電流しゃ断機能とを同時に満たすことはできない。

【0011】そこで本発明は、上述した事情に鑑み、電 流しゃ断時における高蒸気圧性材料から低蒸気圧性材料 へのアークの移行が停滞せずに容易に行なわれ、低サー ジ機能と大電流しゃ断機能という二つの相反する機能を 有した真空期閉器用接点を提供することを目的とする。 [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の真空パルブは、 組成の異なる第1、第2の組成領域と、その間にはさま れた中間領域からなる接点を具備する真空パルプであ る。すなわち、本発明の真空パルブは、高導電性材料と 耐弧性材料とから構成される接点を具備してなる真空パ ルプにおいて、前記接点が、それぞれ組成の異なる第1 組成領域 [I]、第2組成領域 [II]、および該第1組 成領域〔I〕と第2組成領域〔II〕の中間位置に介在す る中間領域 (M) から構成され、前記第1組成領域 [I] が低サージ性のAg-WC系合金からなり、前記 第2組成領域 [II] が大電流遮断性のCu-Cr系合金 からなり、前記中間領域 (M) が前記第1組成領域 [I]と前記第2組成領域 (II) の中間的な性質を有す る合金からなり、前記〔M〕の導電性成分の量が、前記 各領域中の導電性成分量に対して〔II〕>〔M〕> [1] の範囲にあることを特徴とする接点、を具備して なるものである。

【0013】本発明の好ましい態様において、前記第1 組成領域〔Ⅰ〕は、高導電性材料が10~50重量%の Ag、残部の耐弧性材料がWCからなり、前記第2組成 領域〔II〕は、高導電性材料が20~80重量%のC u、残部の耐弧性材料がCrからなる接点、を具備した ものとすることができる。

【0014】本発明の好ましい他の態様において、前記 中間領域(M)は、高導電性材料がAgまたは/および Cu、耐弧性材料がCrまたは/およびWCからなる接 点、を具備したものとすることができる。

【0015】本発明の好ましい他の態様において、前記 第1組成領域〔Ⅰ〕の高導電性材料がAgおよびCuか らなり、該高導電性材料の含有量は10~50重量%の 範囲にあり、Cuの量はAg量に対して40%以内であ る接点、を具備したものとすることができる。

【0016】本発明の好ましい他の態様において、前記 中間領域(M)における耐弧性成分Cr+WCは、前記 第1組成領域 [I] に接する一方の端部から前配第2組 成領域〔II〕に接する他方の端部に向かってCr/WC の比率が前配第1組成領域 [I] の耐弧性成分量から前

は連続的に変化するように構成した接点、を具備したも のとすることができる。

【0017】本発明の好ましい他の態様において、前配 第1組成領域 [I]、前記第2組成領域 (II) および前 記中間領域〔M〕の各領域が、前記接点の中心から半径 方向に (II) (M) (I) の順にまたは (I) (M) (II) の順に配置された接点、を具備してなるものとす ることができる。

[0018]

【作用】本発明の真空パルプに用いる接点は、それぞれ 10 組成の異なる第1組成領域 [I]、第2組成領域 [I I)、および〔I〕と〔II〕の中間位置に介在する中間 領域(M)とから構成され、第1組成領域〔I〕は低サ ージ性に優れたAg-WC系合金、第2組成領域 [II] は大電流遮断性に優れたCu-Cr系合金、中間領域 [M] は[I]と[II]の中間的な性質を有する合金で 構成され、この(M)の導電性成分量が、各領域中の導 **電性成分量に対して (II) > (M) > (I) の範囲にあ** るように構成されている。したがって、低サージ性に重 要な影響を及ぼす導電性成分量が、たとえば円形の接点 20 では、半径方向に対し〔I〕〔M〕〔II〕の順、または [II] [M] [I] の順で変化している。

【0019】このような構成を持つ接点を真空パルプに 用いて電流しゃ断を行なう場合、通電中に接触していた 両接点が離れる際に、接点を構成している領域のうち最 も導電性成分量の少ない材料から成る第1の組成領域 [1] から多くのイオンの放出或いは金属粒子が蒸発し て両接点のこの合金領域同志の間に浮遊し、アークがこ れに導かれて両者の間に接続される。

【0020】この後、磁界の作用により両接点間に存在 30 するイオン、金属粒子の分布を変えると、第1の組成領 域〔I〕から、中間領域〔M〕へアークが向かう。すな わち、高導電性成分の量は第1の組成領域 [1] から中 間領域 [M] を経て第2の組成領域 [II] へ向かうに従 って徐々に高くなるため、アークは停滞することなく容 易に移行する。このようにして磁界の制御により、強制 的にアークを第2の組成領域 (II) へ向かって移行させ ていく。そして低サージ機能が満たされるために、つま りアークが両接点間に接続されているために必要な時間 経過後、Agのない第2の組成領域〔II〕へ移行させる 40 と、この瞬間にアークの接続が断たれることとなる。

【0021】上記の第1組成領域 [I] は、低サージ性 のAg-WC系合金からなる。このAg-WC系合金 は、上述したように優れた低サージ機能を有する合金で ある。本発明においてAg-WC系合金というのは、導 電性材料としてAg、またはAgを主成分としその一部 をCuで置換したものからなり、耐弧性成分としてWC からなる合金を意味する。そして、高導電性材料が10 ~50重量%のAg、残部の耐弧性成分がWCからなる ものであることが好ましい。〔I〕中の導電性成分の量 50 る。図4に示した従来の接点と比較し〔I〕と〔II〕と

が10重量%未満では、裁断電流値が十分低くならず、 またばらつきも大きく、開閉回数の経過とともに裁断の 劣化する傾向にある。一方50重量%を越えると、裁断 **電流値が高く、好ましくない。**

6

【0022】また上記の第1組成領域 [I] 中の高導電 性材料としてはAgに限らずAgおよびCuからなる場 合であっても、該高導電性の含有量が10~50重量% の範囲にあり、Cuの量がAg量に対して40%以内で あれば、中間領域〔M〕の導電性成分量が〔II〕> (M) > (I) の範囲にある限り、アークは電極面全体 に拡がり好ましい遮断特性を示す。

【0023】上記の第2組成領域〔II〕は大電流遮断性 のCu-Cr系合金からなる。このCu-Cr系合金は 上述したように優れた大電流遮断特性を有する合金であ る。ここで、高導電性材料が20~80重量%のCu、 残部の耐弧性材料がCrからなるものであることが好ま しい。 (II) 中の導電性成分の量が20重量%未満で は、アークが十分に〔M〕から〔II〕へ移行しにくい。 一方80重量%を越えると、アークによって〔II〕部の 消耗が大きくなる。

【0024】上記の中間領域 (M) は、上記第1組成領 域 [I] と上記第2組成領域 [II] の中間位置に介在 し、これら〔I〕と〔II〕の中間的性質を有する合金か らなる。このような構成とすることによって、第1組成 領域〔I〕から中間領域〔M〕を経て第2組成領域〔I I) へのアークの移行がスムーズに行われるのである。 この(M)の構成材料としては、その高導電性材料がA gまたは/およびCuからなり、耐弧性材料がCrまた は/およびWCからなるものであることが好ましい。し たがって、中間領域〔M〕の構成材料として具体的に は、Ag-WC、Cu-WC、Ag+Cu-WC、Ag -Cr, Cu-Cr, Ag+Cu-Cr, Ag+Cu-WC+Cr、Ag-WC+CrおよびCu-WC+Cr の組み合わせがあるが、そのいずれのものであっても、 導電性成分量が〔II〕>〔M〕>〔I〕の範囲にある限 り、好ましい遮断性能を示す。

【0025】上記の中間領域(M)における耐弧性材料 としてWC+Crを用いる場合、第1組成領域〔Ⅰ〕に 接する一方の端部から第2組成領域〔II〕に接する他方 の端部に向かってC r / W C の比率を第1組成領域 [I]の耐弧性成分量から前記第2組成領域 [II] の耐 弧性成分量へと段階的にまたは連続的に変化するように 構成すれば、アークが〔I〕→〔M〕→〔II〕へとスム ーズに移行するので好ましい。

[0026]

【実施例】本発明の一実施例として、接点が第1の組成 領域〔I〕としてAg-WC、第2の組成領域〔II〕と してCu-Cr、これらの中間の領域 (M) からなる場 合について、接点を上部から見た図1を用いて説明す

の間に中間領域〔M〕が配されている点が異なる。

【0027】次に、本発明に係る接点の低サージ性およ び大電流しゃ断性について試験評価した結果について説 明する。それぞれの接点の有する低サージ機能、大電流 しゃ断機能を比較対照するため、両接点間を接触した状 態における接点圧、この状態から離していくときの開極 スピード、真空度を同一条件とした。

【0028】低サージ性の優劣は、離れている両接点間 にアークが接続されるために必要な電流さい断値の大小 により評価することができ、この値が小さいほど低サー 10 ジ性に優れることとなる。LC回路を介し、44AのA C電流を与えたとき、真空しゃ断器に直列に挿入した同 軸シャントの電圧降下をオシロスコープで測定し、電流 さい断値を算出した。

【0029】大電流しゃ断性の優劣は、しゃ断成功した ときの電流の大きさ、すなわちその電流の最大値により 評価することができ、この値が大きいほど大電流しゃ断 性に優れることとなる。接点表面をペーキング、電圧工 ージング等によりクリーニングして条件を一定にした 後、7. 2KV、50Hzで1KAずつ電流を増加しな 20 がらしゃ断限界時における電流の最大値を測定し、所定 の標準値に対する倍率をしゃ断倍率として算出した。

以上の各接点に対するサージ電流値およびしゃ断倍率を

示した表1、2を参照し、本発明による接点の有する効

【0030】実施例1、比較例1~2

果について説明する。実施例1、および比較例1,2 は、いずれも低裁断材料の33Ag-WCを、図1での (21) すなわち第1の組成領域 [I] に、大電流しゃ 断材料の50Cu-Crを第2の組成領域 (II) すなわ ち図1での(23) に用いた。これに対して[I] (I 30 I) の間に存在する中間領域 (M) すなわち図1での (22) には、導電成分Agの量を15wt% (比較例 -1)、42wt% (実施例-1)、75wt% (比較 例-2) として評価したところ、 [M] のAgの量が [I]と[II]の導電性材料の中間の量の場合には、 [I] に点弧したアークが (II) にまで広がり、電極面 積を有効に活用できる結果、優れたしゃ断性能を示した (実施例-1)。これに対して [M] のAgの量が15 wt%の場合、すなわち〔I〕のAg(導電性材料)の 量より少ない場合 (比較例−1) には、アークが [I] と〔M〕との境界で固着する傾向にあり、電極面を有効 に活用できず、しゃ断特性は充分でなかった (比較例-1)。一方 [M] のAgの量が75wt%の場合、すな わち(II)の導電性材料(Cu)の量より多い場合(比 較例-2)には、アークが〔M〕と〔II〕の境界に固着 する傾向にあり、しゃ断性能の優れた〔II〕の領域の5 0 C u - C r の能力を充分発揮することができず、しゃ 断特性は充分でなかった(比較例-2)。以上から中間 領域 [M] の高導電性材料の量は [II] > [M] > 〔I〕の範囲にあることが必要である。

【0031】実施例2、比較例3~4

上記した事例は中間領域(M)の導電性成分としてAg を用いたAg-WCについて述べたが、導電性成分とし てCuを用いたCu-WCにおいても同じ傾向を得た。 すなわち、〔M〕のCuの量が〔I〕と〔II〕の導電性 成分の中間の量の場合には、〔1〕で点弧したアークが [II] にまで速やかに広がり、電極表面を有効に活用し ている結果、優れたしゃ断性能を発揮した(実施例-2)。これに対して [M] のCuの量が20wt%の場 合、すなわち〔I〕のAg(導電性材料)の量より少な い場合(比較例-3)には、アークが[I]と[M]と の境界に停滞する傾向にあり、アーク集中による電極の 損傷によってしゃ断特性は充分でなかった(比較例-3)。一方 [M] のCuの量が70wt%の場合、すな わち〔II〕のCu(導電性成分)の量より多い場合(比 較例-4)には、アークが〔M〕と〔II〕の境界に固着 する傾向にあり、しゃ断性能の優れた〔II〕の領域の5 OCu-Crの能力を充分発揮することができず、好ま しいしゃ断特性を得ることはできなかった(比較例-4)。以上から中間領域 [M] の高導電性材料の量は、 前述実施例-1で述べたAgの場合と同様に(II)> [M] > [I] の範囲にあることが望ましい。

【0032】実施例3~7

[M] に使用する接点は、上記実施例1, 2で示したよ うなAg-WC、Cu-WCに限らず、Ag-Cr、C u-Cr (実施例3~4)でも上記したように導電性成 分の量が〔II〕>〔M〕>〔I〕を満すとき、好ましい しゃ断性能を得た。同様に [M] に使用する接点の導電 性成分がAg+Cuでも同様な効果を得た(実施例5~ 7)。耐弧性成分がWC+Crであっても同様の効果が 得られた(実施例-7)。

【0033】実施例-8

実施例1~7、比較例1~4では、第1の組成領域 [I]としてAg-WC合金の例で示したが、これに限 ることなく導電性成分がAg+Cuであっても、その合 計量が29wt%の場合、中間領域 (M) の導電性成分 の量が〔II〕>〔M〕>〔I〕の範囲にあれば好ましい しゃ断特性を示した(実施例-8)。この場合には前記 実施例と同様、アークは電極面全体に良好に拡がってい 40 る。

【0034】実施例9~10、比較例7~8

上記によって中間領域 [M] の存在によって第2の組成 領域〔II〕の材料の有するしゃ断特性を充分発揮させる 条件として合金中の導電性成分の量を〔II〕>〔M〕> [1]とすることが必要であることが判った。一方、第 1の組成領域〔Ⅰ〕中の導電成分の量が、4wt%Ag のときには、裁断電流値は充分に低く(改善)されず、 またばらつきも大きく(比較例-7)、少なとくも10 wt%Ag(実施例-9)であることが必要でありま 50 た、同じく [I] 中の導電成分の量が75wt%Agの

ときには、裁断電流値は高く、好ましくない(比較例-8)。これらより本発明での真空パルプでは第1の組成領域〔1〕中の導電性成分の量は10-50wt%が好ましい。特に4Ag-WC(比較例-7)では開閉回数の経過と共に裁断の劣化(裁断電流値が高くなる)の傾向にある。

[0035] <u>実施例11~13、比較例9~10</u> 第2の組成領域 [II] に用いるCu-Cr合金中の導電 性成分の量が、10wt%Cuでは、アークが十分には %Cuでは、アークによって [II] 部の消耗が大きい。従って第2の組成領域 [II] における導電性成分の量は $20 \sim 80$ wt %の範囲にあることが好ましい。以上示したように [M] の導電成分の量は [II] > [M] > [I] の範囲にあることが必須であり、この範囲にあるならば [M] における導電成分は単一成分でなく多成分であってもよく、特に [II] から [I] に向って連続的にまたは段階的に変化していてもよい。

10

[0036]

(M) から (II) への移行が見られず、また、95wt*10 【表1】

	*	A # 0 #	ı a	***	* #	
	第1の組成価値 (1)	352 CARRESTA (11)	. 中 展 仮 株 00	(A)	*	3
比较第一1	39AE-WC	8 B C u - C r	15AF-WC	1, 9-2, 8	0. 8	アータが以 ・・ 四 へき行せず
実施男-1	•	-	42A1-WC	•	1. 0	
此解例-2	•		78Ag-WC	•	G. 8	アークが詳 →[[1]へ事もず、 電極直義を有効に返現出来ない
HMM-3	- '	•_	20Cu-WC		G. 7	アークは、5) 一枝 への部行 が見られない
实验例—2	•		4'0 C u ~ W C	•	1, 1	
注款第 -4	.	•	TOCH-WC	•	0. 8	アーナが前 に外掛し、電温器 職を実効に原理出来ない
黄油門一3	•	1	40Ag-Cr	•	1, 2	
2004-4	•	•	400u-01	•	1. 3	
#3h#1 6			30Ag-12Cu-WC	•	1. 2	
9 - Pales	-	•	80As-12Cu-Cr	•	1. 4	
#3661-7	•	•	30Ag-12Cu-53WC-Cr	•	1, 3	
30364 -8	2 DA E - 9 Ca - WC	-	42Ag-WC	1. 5~1. 9	1. 0	

[0037]

【表2】

	*	A \$ 0 #	政	果斯司技術	2 6	
	第1の観点仮城 [1]	第2の組成領域 ((1)	中間毎★040	(A)	*	4 4
比较何7	4Ag~WC	50C=-Cr	42Ag-WC	1. 5~6. 5	1. 0	関羽の低温で装飾値は著しく劣化
实施例一日	10Ag-WC '	•	•	1. 5~2. 0	. •	
实施例 一14	5 OAg-WC	•	•	2. 0~2. 3	,	
出館列 -8	7 SAg-WC	•	•	5. 5~8. 5	•	
比較何-9	10Ag-WC	10Cu-Cr	15Az-WC	1. 5~2. 0	0. 6	アータは十分に(M)→(II)への参行が 行むれない
実施列(1	•	20Cu-Cr	•		0. 9	
突胎件—12	•	40Cu-Cr	•		1. 0	
实验例—13	•	80 Cu - Cr	30Ag-WC		1. 2	
比較例一10	*	95Cu~Cr	•	•	0. 8	アータによる(II) 傷の消耗が大きい

[0038]

50 【発明の効果】以上説明したように、本発明による真空

11

開閉器用接点は、低サージ機能を有するAg-WC系合 金領域と、大電流しゃ断機能を有するCu-Cr系合金 領域とを少なくとも2種類有し、それぞれの合金領域の 間に、これら両合金領域の中間的な性質を有する合金か らなり、その導電性成分量が、Cu-Cr系合金領域> 中間領域>Ag-WC系合金領域、の範囲にある境界領 域を有する。このため、Ag-WC系合金領域からCu -Cr系合金領域への磁界の制御による強制的なアーク の移行が容易に行なわれて停滞することがなく、低サー ジ機能と大電流しゃ断機能という二つの相反する要求を 10 同時に満たすことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の真空開閉器用接点の一実施例を示す

【図2】真空期閉器を示す図。

【図3】図2における可動電極8周辺の詳細を示す部分 拡大図。

【図4】従来の真空開閉器用接点を示す図。

【図5】 真空開閉器に用いられるコイル電極を示す図。

【図6】真空開閉器に用いられるスパイラル電極を示す 20 44 コイル電極

【符号の説明】

1 しゃ断室

2 絶縁容器

3 a 封止金具

3 b 封止金具

4 a 金属製蓋体

4 b 金属製蓋体

5 導電棒

6 導電棒

7 固定電極

8 可動電極

9 ペローズ

10 アークシールド

11 アークシールド

12 ろう付

13a 可動接点

13b 固定接点

14 ろう付

21 第1の組成領域 [I]

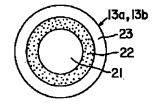
22 中間領域 (M)

23 第2の組成領域 [II]

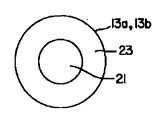
45 スパイラル電極

H 磁界

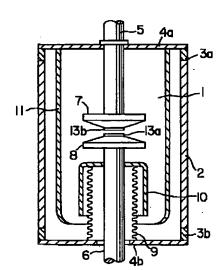




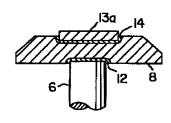
【図4】

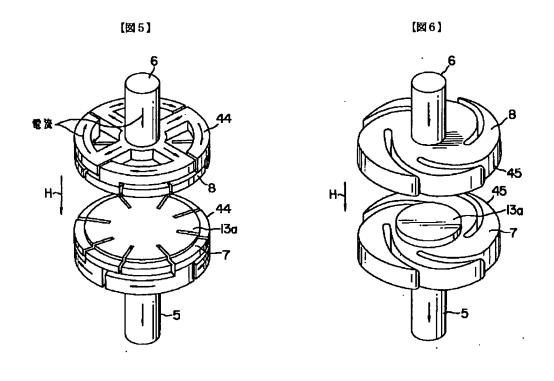






[図3]





フロントページの続き

(72)発明者 山 本 敦 史 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中 工場内